

中国集成电路封装行业市场发展分析及前景趋势与投资发展战略研究报告(2026-2031版)

报告简介

《国家集成电路产业发展推进纲要》明确了中国集成电路产业发展的四大任务：着力发展集成电路设计业、加速发展集成电路制造业、提升先进封装测试业发展水平、突破集成电路关键装备和材料。《国家集成电路产业发展推进纲要》提出，2020年与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%;2030年产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越式发展。

半导体下游应用广泛，涵盖消费电子、电力电子、交通、医疗、通讯技术、医疗、航空航天等众多领域。近年来，随着物联网、人

工智能、云计算、大数据、5G、机器人等新兴应用领域的蓬勃发展，各类半导体产品的使用场景和用量不断增长，为半导体产业注入了新的增长动力。根据美国半导体产业协会的数据，全球半导体销售额从 2011 年的 3,003.4亿美元增长至2021年的5,475.8亿美元，2011-2021年CAGR为4.46%，市场规模稳步增长。

根据Frost & Sullivan数据，全球封测市场规模从2016年的510.00亿美元增长至2020年的594.00亿美元，保持着平稳增长。受益于产业政策的大力支持以及下游应用领域的需求带动，国内封装测试市场增长较快，国内封测市场规模从2016年的1,564.30亿元增长至2020年的2,509.50亿元，年均复合增长率为12.54%，远高于全球封测市场3.89%，其中2020年先进封装市场规模为351.30亿元。全球集成电路封测产业进入稳步发展期，而中国封测产业发展仍保持较高增速，2017年到2021年的年复合增长率约为9.9%。目前，先进封装引领全球封装市场增长。全球封装市场按技术类型来看，先进封装的增速远高于传统封装，预计到2026年，先进封装总体市场份额将超过50%，成为封装产业增长的核心动力。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工业和信息化部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国半导体行

业协会封装分会、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国集成电路封装及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代技术、发展趋势、新技术等进行了分析，并重点分析了中国集成电路封装行业发展状况和特点，以及中国集成电路封装行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的集成电路封装行业发展态势作了详细分析，并对集成电路封装行业进行了趋向研判，是集成电路封装经营、开发企业，服务、投资机构等单位准确了解目前集成电路封装业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

报告目录

第一部分 产业环境透视

【全球经济形势缓慢复苏的背景下，中国集成电路封装行业运行如何？中国集成电路封装业在国际市场上有什么优势？技术发展水平如何？】

第一章 中国集成电路封装行业发展背景

第一节 集成电路封装行业定义及分类

一、集成电路封装行业定义

二、集成电路封装行业产品大类

三、集成电路封装行业特性分析

1、行业周期性

2、行业区域性

3、行业季节性

四、集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析

第二节 集成电路封装行业发展环境分析

一、行业管理体制

二、行业相关政策

三、宏观经济趋势

四、集成电路封装技术演进

五、集成电路封装形式应用领域

六、集成电路封装工艺流程

七、集成电路封装行业新技术动态

第二部分 行业深度分析

【集成电路封装业整体运行情况怎样?行业各项经济指标运行如何?集成电路封装市场供需形势怎样?集成电路封装业有哪些新形势?】

第二章 中国集成电路产业发展分析

第一节 集成电路产业发展状况

一、集成电路产业链简介

二、集成电路产业发展现状

三、集成电路产业市场规模

四、集成电路产业市场结构

1、集成电路市场产品结构

2、集成电路市场应用结构

五、集成电路市场竞争格局

六、集成电路产业区域发展格局

七、集成电路产业面临的发展机遇

八、集成电路产业面临的主要问题

第二节 集成电路设计业发展状况

一、集成电路设计业发展概况

二、集成电路设计业市场规模

三、集成电路设计业产业特征

四、集成电路设计业竞争格局

五、集成电路设计业发展趋势

六、集成电路设计业发展思路和政策建议

第三节 集成电路制造业发展状况

一、集成电路制造业发展现状

二、集成电路制造业发展特点

三、集成电路制造业发展规模

四、集成电路制造业财务指标

五、集成电路制造业供需平衡

1、全国集成电路制造业供给情况

2、全国集成电路制造业需求情况

3、全国集成电路制造业产销率

第三章 中国集成电路封装行业整体运行指标分析

第一节 中国集成电路封装行业整体发展情况

一、集成电路封装行业发展现状

二、集成电路封装行业发展特点

三、集成电路封装行业利润水平

四、大陆厂商与业内领先厂商的技术比较

第二节 2021-2026年中国集成电路封装行业总体分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第三节 2021-2026年中国集成电路封装行业财务指标

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第四章 中国集成电路封装行业市场需求分析

第一节 计算机领域对行业的需求分析

一、计算机市场发展现状

二、集成电路在计算机领域的应用

三、计算机领域对行业需求的拉动

第二节 消费电子领域对行业的需求分析

一、消费电子市场发展现状

二、集成电路在消费电子领域的应用

三、消费电子领域对行业需求的拉动

第三节 通信设备领域对行业的需求分析

一、通信设备市场发展现状

二、集成电路在通信设备领域的应用

三、通信设备领域对行业需求的拉动

第四节 工控设备领域对行业的需求分析

一、工控设备市场发展现状

二、集成电路在工控设备领域的应用

三、工控设备领域对行业需求的拉动

第五节 汽车电子领域对行业的需求分析

一、汽车电子市场发展现状

二、集成电路在汽车电子领域的应用

三、汽车电子领域对行业需求的拉动

第六节 其他应用领域对行业的需求分析

第五章 中国集成电路封装技术发展分析

第一节 半导体封测技术分析

一、中国半导体行业发展概况

二、半导体行业景气预测

三、半导体封装技术分析

1、封装环节产值逐年成长

2、封装环节外包是未来发展趋势

第二节 集成电路封装类专利分析

一、专利分析样本构成

1、数据库选择

2、检索方式

二、封装类专利分析

1、专利公开年度趋势

2、国内外专利公开趋势对比

3、国内专利公开主要省市分布

4、ipc技术分类趋势分布

5、主要权利人分布情况

第三节 集成电路封装过程部分技术问题探讨

一、集成电路封装开裂产生原因分析及对策

1、封装开裂的影响因素分析

2、管控影响开裂的因素的方法分析

二、集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策

1、产生芯片弹坑问题的因素分析

2、预防芯片弹坑问题产生的方法

第三部分 市场全景调研

【bga封装、sip封装、sop封装.....各细分市场情况如何?竞争格局情况如何?产业链上下游环节有什么变化?前景如何?】

第六章 中国集成电路封装行业产品市场分析

第一节 集成电路封装行业bga产品市场分析

一、bga封装技术

二、bga产品主要应用领域

三、bga产品需求拉动因素

四、bga产品市场应用现状分析

五、bga产品市场前景展望

第二节 集成电路封装行业sip产品市场分析

一、sip封装技术

二、sip产品主要应用领域

三、sip产品需求拉动因素

四、sip产品市场应用现状分析

五、sip产品市场前景展望

第三节 集成电路封装行业sop产品市场分析

一、sop封装技术

二、sop产品主要应用领域

三、sop产品市场发展现状

四、sop产品市场前景展望

第四节 集成电路封装行业qfp产品市场分析

一、qfp封装技术

二、qfp产品主要应用领域

三、qfp产品市场发展现状

四、qfp产品市场前景展望

第五节 集成电路封装行业qfn产品市场分析

一、qfn封装技术

二、qfn产品主要应用领域

三、qfn产品市场发展现状

四、qfn产品市场前景展望

第六节 集成电路封装行业mcm产品市场分析

一、mcm封装技术水平概况

1、概念简介

2、mcm封装分类

二、mcm产品主要应用领域

三、mcm产品需求拉动因素

四、mcm产品市场发展现状

五、mcm产品市场前景展望

第七节 集成电路封装行业csp产品市场分析

一、csp封装技术水平概况

1、概念简介

2、csp产品特点

3、csp封装分类

二、csp产品主要应用领域

三、csp产品市场发展现状

四、csp产品市场前景展望

第八节 集成电路封装行业其他产品市场分析

一、晶圆级封装市场分析

1、概念简介

2、产品特点

3、主要应用领域

4、市场规模与主要供应商

5、前景展望

二、覆晶/倒封装市场分析

1、概念简介

2、产品特点

3、市场前景

三、3d封装市场分析

1、概念简介

2、封装方法

3、封装特点

4、发展现状与前景

第四部分 竞争格局分析

【集成电路封装市场竞争程度怎样?集中度有什么变化?重点企业市场占有率有什么变化?行业的并购重组有什么趋势?】

第七章 集成电路封装行业市场竞争分析

第一节 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

一、现有竞争者之间的竞争

二、上游议价能力分析

三、下游议价能力分析

四、行业潜在进入者分析

五、替代品风险分析

第二节 集成电路封装行业国际竞争格局分析

一、国际集成电路封装市场发展状况

二、国际集成电路封装市场竞争状况

三、国际集成电路封装市场发展趋势

四、跨国企业在华市场竞争力分析

第三节 集成电路封装行业国内竞争格局分析

一、国内集成电路封装行业竞争格局分析

二、国内集成电路封装行业集中度分析

1、行业销售收入集中度分析

2、行业利润集中度分析

3、行业工业总产值集中度分析

三、中国集成电路封装行业国际竞争力分析

第八章 2026-2031年集成电路封装行业领先企业经营形势分析

第一节 杭州士兰微电子股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第二节 天水华天科技股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第三节 威讯联合半导体(北京)有限公司

- 一、企业发展简况
- 二、企业经营情况
- 三、企业集成电路业务
- 四、企业业务扩张及融资渠道
- 五、企业竞争状况优劣势
- 六、企业最新发展动向

第四节 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司

- 一、企业发展简况
- 二、企业经营情况
- 三、企业集成电路业务
- 四、企业业务扩张及融资渠道
- 五、企业竞争状况优劣势
- 六、企业最新发展动向

第五节 通富微电子股份有限公司

- 一、企业发展简况
- 二、企业经营情况
- 三、企业集成电路业务
- 四、企业业务扩张及融资渠道
- 五、企业竞争状况优劣势
- 六、企业最新发展动向

第六节 恩智浦半导体(天津)有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第七节 江苏长电科技股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第八节 吉林华微电子股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第九节 无锡华润安盛科技有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第十节 江阴苏阳电子股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业经营情况

三、企业集成电路业务

四、企业业务扩张及融资渠道

五、企业竞争状况优劣势

六、企业最新发展动向

第五部分 发展前景展望

【要想在如今竞争激烈的市场上站稳脚跟，应紧随市场的脚步向前发展进步，那么未来集成电路封装行业发展前景怎样?投资机会在哪里?】

第九章 2026-2031年集成电路封装行业前景及趋势预测

第一节 2026-2031年集成电路封装行业发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第二节 2026-2031年集成电路封装市场发展前景

一、疫情影响下集成电路市场需求前景分析

二、2026-2031年集成电路封装产业链发展前景

三、“十四五”时期我国集成电路封装市场发展前景

四、集成电路先进封装的增速远高于传统封装

第三节 2026-2031年中国集成电路封装行业发展预测

一、2026-2031年中国集成电路封装市场规模预测

二、2026-2031年中国集成电路封装行业供给预测

三、2026-2031年中国集成电路封装行业需求预测

四、2026-2031年集成电路封装行业发展趋势预测

第四节 中国集成电路封装行业存在的问题及对策

一、中国集成电路封装行业存在的问题

二、集成电路封装行业发展的建议对策

第十章 2026-2031年集成电路封装行业投资价值评估分析

第一节 集成电路封装行业投资特性分析

一、集成电路封装行业进入壁垒分析

二、集成电路封装行业盈利因素分析

三、集成电路封装行业盈利模式分析

第二节 集成电路封装行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

四、集成电路封装行业投资现状分析

第三节 中国集成电路产业投资基金

一、国家集成电路产业投资基金

1、大基金基本情况

2、大基金的重要意义

3、大基金一期投资情况

(1)投资企业梳理

(2)投资方式分析

(3)投资领域分析

(4)一期成果汇总

4、大基金二期投资动态

5、大基金取得的成效

6、大基金下一步的工作思路

二、芯片产业基金地方动态分析

三、推进中国芯片产业发展的投融资建议

1、鼓励发展集成电路产业风险和私募投资资本

2、积极参与海外收购，集中建立产业园

3、加强与国际资本合作，推动中国企业走出去

4、建设集成电路投融资平台，促进资本和产业的交流

第四节 2026-2031年集成电路封装行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、集成电路封装行业投资机遇

第五节 2026-2031年集成电路封装行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第六节 中国集成电路封装行业投资建议

一、集成电路封装行业主要投资建议

二、中国集成电路封装企业融资分析

第六部分 发展战略研究

【集成电路封装业有哪些案例参考?如何制定发展战略?】

第十一章 集成电路封装行业案例分析研究

第一节 集成电路封装行业并购重组案例分析

一、集成电路封装行业并购重组成功案例分析

二、集成电路封装行业并购重组失败案例分析

三、经验借鉴

第二节 集成电路封装行业经营管理案例分析

一、集成电路封装行业经营管理成功案例分析

二、集成电路封装行业经营管理失败案例分析

三、经验借鉴

第三节 集成电路封装行业营销案例分析

- 一、集成电路封装行业营销成功案例分析
- 二、集成电路封装行业营销失败案例分析
- 三、经验借鉴

第十二章 集成电路封装行业发展战略研究

第一节 集成电路封装行业发展战略研究

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第二节 对中国集成电路封装品牌的战略思考

- 一、集成电路封装品牌的重要性
- 二、集成电路封装实施品牌战略的意义
- 三、集成电路封装企业品牌的现状分析
- 四、中国集成电路封装企业的品牌战略
- 五、集成电路封装品牌战略管理的策略

第三节 集成电路封装经营策略分析

- 一、集成电路封装市场细分策略
- 二、集成电路封装市场创新策略
- 三、品牌定位与品类规划

四、集成电路封装新产品差异化战略

第四节 集成电路封装行业发展战略研究

一、2026-2031年集成电路封装行业投资战略

二、2026-2031年细分行业投资战略

图表目录

图表：集成电路封装行业生命周期

图表：集成电路封装行业产品分类

图表：中国集成电路封装企业地区分布

图表：集成电路封装行业主要政策分析

图表：2021-2026年全球集成电路产品构成

图表：2021-2026年全球主要经济体经济增长速度

图表：2021-2026年各项全球pmi指数变动情况

图表：2021-2026年中国gdp增长趋势图

图表：封装技术的演进

图表：各种集成电路封装形式应用领域

图表：集成电路封装工艺流程

图表：集成电路产业链示意图

图表：2021-2026年中国集成电路产业结构分析

图表：中国集成电路产业长三角地区分布概况

图表：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析

图表：2021-2026年中国集成电路设计市场销售额走势

图表：集成电路设计业新发展策略

图表：集成电路制造业发展主要特点分析

图表：2021-2026年集成电路制造业规模分析

图表：2021-2026年中国集成电路制造业盈利能力分析

图表：2021-2026年中国集成电路制造业运营能力分析

图表：2021-2026年中国集成电路制造业偿债能力分析

图表：切筋凸模的一般设计方法

图表：管控影响开裂的因素的方法分析

图表：2021-2026年中国集成电路销售收入及增长情况

图表：2021-2026年中国集成电路市场产品结构图

图表：2021-2026年中国集成电路市场应用结构图

图表：2021-2026年中国集成电路市场品牌竞争结构

图表：2026-2031年全球it支出预测

图表：2026-2031年亚太地区it支出预测

图表：2021-2026年中国通信设备制造业主要经济指标

图表：集成电路封装技术在医疗电子领域应用分析

图表：中国集成电路封装测试行业企业类别

图表：集成电路封装行业上游议价能力分析

图表：集成电路封装行业下游议价能力分析

图表：集成电路封装行业潜在进入者威胁分析

图表：集成电路封装行业替代品威胁分析

图表：全球各封装技术产品产量构成表

图表：全球前十大集成电路封装测试企业排名

图表：各种电子产品的介电常数

图表：dnp将部件内置底板“b2it”薄型化

图表：“megtron4”的电气特性和耐热性

图表：2021-2026年台湾矽品公司简明损益表

图表：2021-2026年中国十大集成电路封装测试企业

图表：bga封装技术特点分析

图表：bga封装技术分类

图表：pbga(塑料焊球阵列)封装

图表：cmmb应用市场结构

图表：cmmb芯片产业链示意图

图表：带有倒装、打线等多种技术的3d sip封装示意图

图表：sip产品应用领域分析

图表：sop封装产品

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：309678

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20221208/309678.shtml>

在线订购：[点击这里](#)